**企业技术难题及合作意向表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 中芯国际 | | |
| **详细地址** | 北京经济技术开发区文昌大道18号 | | |
| **意向合作中科院单位** | |  | |
| **所属产业类别** | □新一代信息技术产业 □新能源汽车与智能网联汽车产业 □生物技术与大健康产业 □机器人与智能制造产业 √其他，请说明 集成电路 | | |
| **企业简介** | 中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务，包括逻辑芯片，混合信号/射频收发芯片，耐高压芯片，系统芯片，闪存芯片，EEPROM芯片，图像传感器芯片电源管理，微型机电系统等。 | | |
| **技术需求** | **技术需求名称** | | **需求详情、技术基础及合作意向** |
| 高精密中空圆形真空编码器 | | 集成电路大量使用高精密圆环形真空编码器，由于国内成熟产品空白，目前国内均采用国外产品，在集成电路设备行业属于卡脖子技术，需要有自主替代能力；技术要求：  分别率： 22位 ； 精度：小于5角秒；  真空度：10-9 Torr ； 尺寸： 圆光栅 满足尺寸 |
| **预期取得的主要成果和效益** | 批量生产高精密编码器，解决高精密中空圆形真空编码器空白问题，实现和马达电机配套替代，解决生产中涉A设备受限马达电机的自主替代。 | | |
| **希望政府部门协调解决的问题和相关建议** | 期望有相关研发机构或企业能够研发并生产该类产品，政府能够对初期研发投入进行鼓励培育或立项解决。 | | |